

**OMNIMATE Data - gniazda RJ45
RJ45C5E S1U 0.9N4N RL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Asortyment produktów obejmuje następujące konstrukcje:

- 90°, leżąca (pozioma) oraz 180°, stojąca (pionowa)
- górny zatrzask / dolny zatrzask
- Procesy lutowania THT, THR lub SMD
- Szeroki wybór różnorodnych konstrukcji, także z wbudowanymi kontrolkami LED oraz zaciskami ekranu
- Klasa parametrów Kat. 3 do Kat. 6
- Pakowane albo na tacy (TY) lub na rolce (taśma na szpuli, RL)

Właściwości i zalety:

- Rozszerzony zakres temperatur od -40°C do +85°C umożliwiające użytkowanie w różnorodnych warunkach
- Wzmocniona warstwa złota (30µm) dla lepszego zabezpieczenia przed korozją
- Odstęp minimum 3 mm zapewnia idealne rezultaty lutowania.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	RJ45C5E S1U 0.9N4N RL
Nr zam.	1455220000
Wykonanie	Złącze wtykowe do druku, Gniazda RJ45, Cat. 5e , Przyłącze lutowane SMD, 90°, Opcja zatrzaskiwania: góra, Zaciski ekranu: brak, 30-80 µm Ni / 30- µm Au , LED: Nie, Liczba biegunów: 8, Tape
GTIN (EAN)	4050118261516
J. op.	200 Szt.
opakowanie	Tape

**OMNIMATE Data - gniazda RJ45
RJ45C5E S1U 0.9N4N RL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	16,41 mm	Szerokość (cale)	0,646 inch
Wysokość	15,19 mm	Wysokość (cale)	0,598 inch
Najmniejsza wysokość montażu	13,41 mm	Głębokość	16,6 mm
Głębokość (cale)	0,654 inch	Masa netto	0,009 g

Temperatury

Temperatura magazynowania, max.	85 °C	Temperatura magazynowania, min.	-40 °C
Temperatura pracy, max.	85 °C	Temperatura pracy, min.	-40 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Specyfikacje systemu

Cykle wpinania	750	Długość pinu do lutowania (l)	3,5 mm
Ekranowanie	Tak	Kategoria	Cat. 5e
LED	Nie	Liczba biegunów	8
Materiał ekranu	stop miedzi	Okablowanie	8-żyłowy
Opcja zatraskiwania	górze	Powierzchnia ekranu	niklowany
Raster w mm (P)	1,27 mm	Raster w calach(P)	0,05 inch
Rodzaj przyłącza	złącze żeńskie	Rodzina produktów	OMNIMATE Data - gniazda RJ45
Stopień ochrony	IP20	Zaciski ekranu	brak
kąt odejścia	90°	liczba kołków lutowanych na biegun	1
montaż na płytce drukowanej	Przyłącze lutowane SMD		

Właściwości elektryczne

Prąd znamionowy	1,5 A	Wytrzymałość izolacji	> 500 MΩ
Wytrzymałość napięciowa styk / styk	≥ 1000 V DC	napięcie znamionowe	125 V AC

Dane materiałowe

Materiał izolacyjny	PA 9T	Barwny	czarny
Tabela kolorów (podobny)	RAL 9011	grupa materiałów izolacyjnych	II
CTI	≥ 500	Wytrzymałość izolacji	> 500 MΩ
Moisture Level (MSL)	1	Klasa palności wg UL 94	V-0
podstawowy materiał styku	Fosforo-brąz	Powierzchnia styku	Złoto na niklu
Struktura warstwowa wtyku	30-80 μ" Ni / 30- μ" Au	Temperatura magazynowania, min.	-40 °C
Temperatura magazynowania, max.	85 °C	Temperatura pracy, min.	-40 °C
Temperatura pracy, max.	85 °C		

Opakowanie

opakowanie	Tape	Długość VPE	45 mm
Szerokość VPE	330 mm	Wysokość VPE	330 mm
Średnica rolki taśmy Ø (A)	330 mm	Odporność powierzchni	Rs = 10 ⁹ - 10 ¹² Ω

**OMNIMATE Data - gniazda RJ45
RJ45C5E S1U 0.9N4N RL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC002637	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-44-04-02	eClass 9.1	27-44-04-02

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

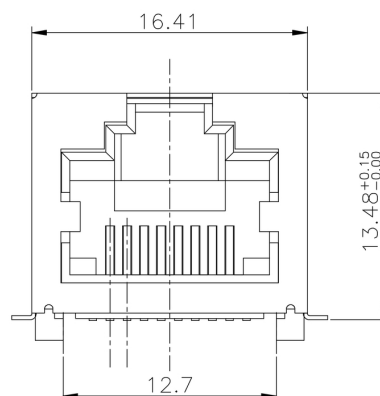
Broszura/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

OMNIMATE Data - gniazda RJ45 RJ45C5E S1U 0.9N4N RL

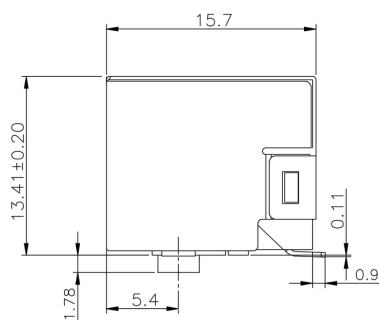
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

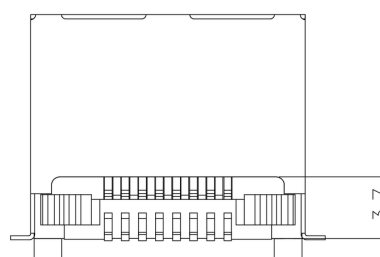
Rysunek wymiarowy



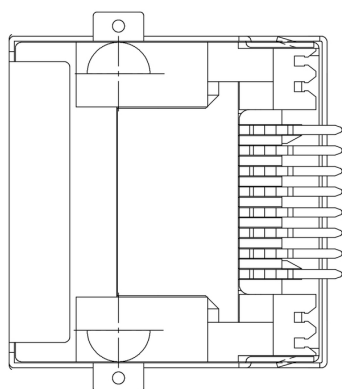
Rysunek wymiarowy



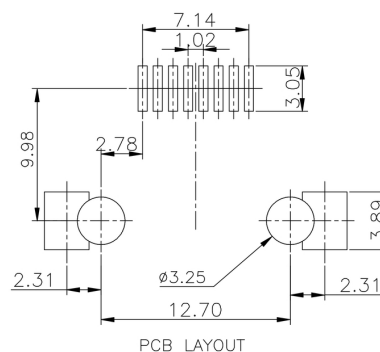
Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy



Układ płytek obwodu drukowanego

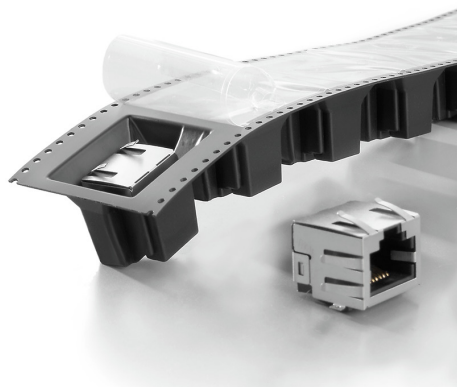


**OMNIMATE Data - gniazda RJ45
RJ45C5E S1U 0.9N4N RL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Zalety produktu



Process-optimised packaging
Tape-on-reel or tray

Zalety produktu

Zalety produktu



Trouble-free assembly
Short, chamfered solder pins



Suitable for all soldering processes
SMT, THT or THR

Data sporządzenia 3 lipca 2019 16:12:25 CEST

Aktualizacja katalogu 07.06.2019 / Zmiany techniczne zastrzeżone

OMNIMATE Data - gniazda RJ45

RJ45C5E S1U 0.9N4N RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Rysunki

Legenda

RJ45	G1	R1	U1	3.2E	E4	GY/GY	TY	RJ45G1 R1U 3.2E4GY/GY TY
								</

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.